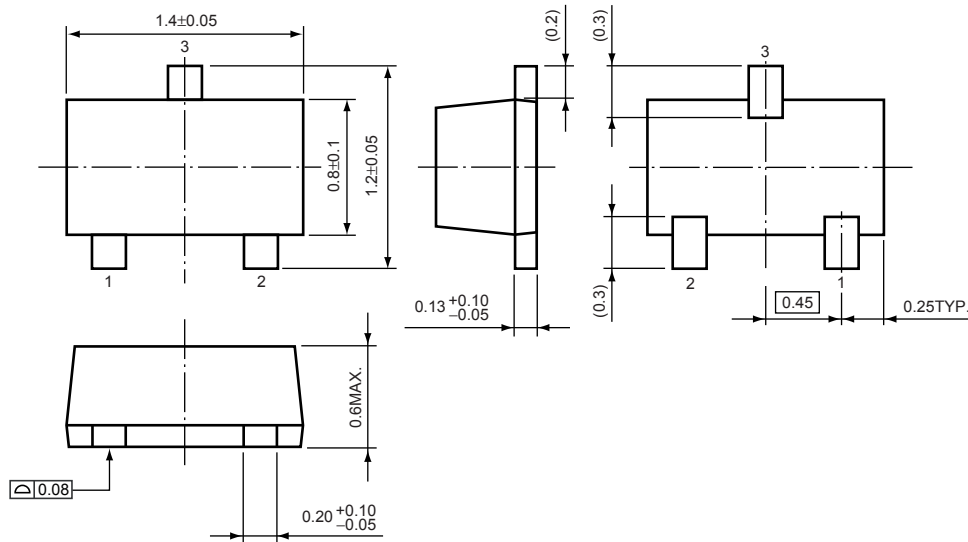


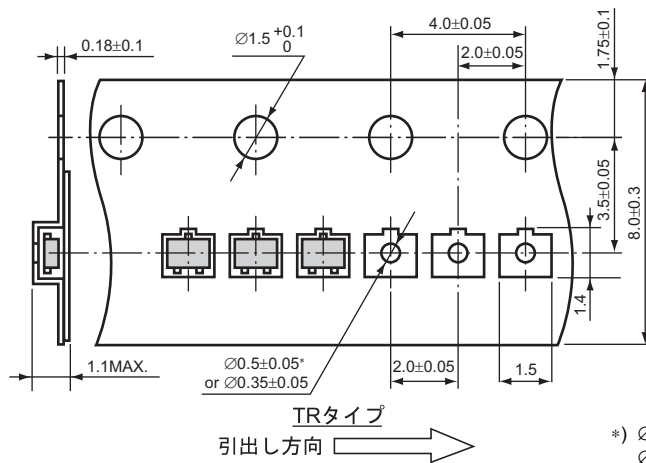
SON1408-3

単位: mm

■ パッケージ外形図



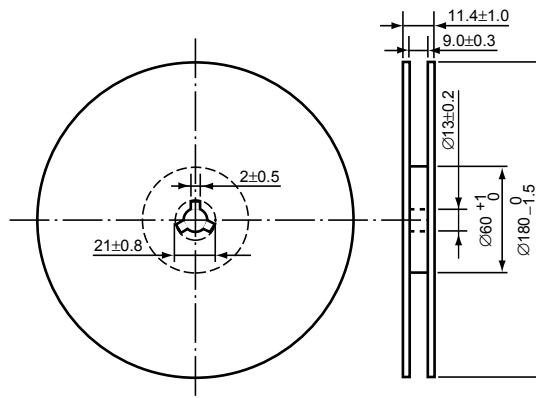
■ テーピング仕様



*) $\varnothing 0.5 \pm 0.05$ の在庫がなくなり次第、
 $\varnothing 0.35 \pm 0.05$ へ切り替わります。

■ テーピングリール外形図 リユースリール(EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=9000 個)



■ 許容損失について (SON1408-3)

SON1408-3パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

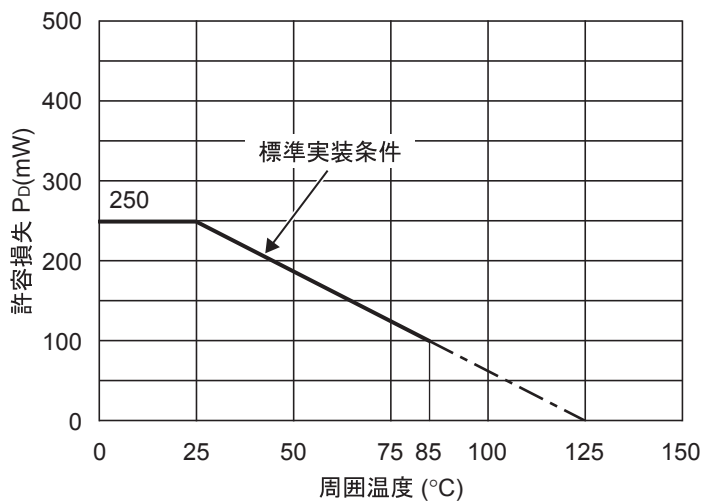
測定条件

	標準実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.8mm × 24 個

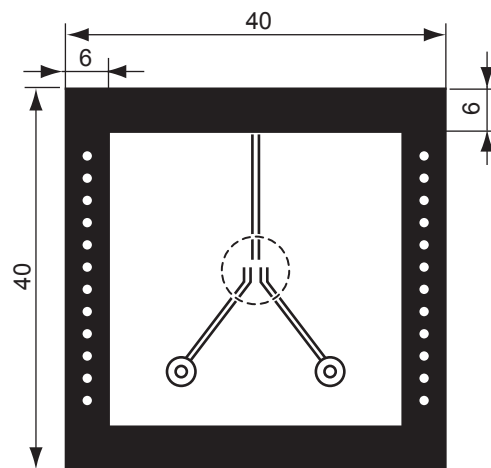
測定結果

(T_{opt}=25°C, T_{jmax}=125°C)

	標準実装条件
許容損失	250mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.25\text{ W} = 400^\circ\text{C/W}$



許容損失特性例



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

■ 基板パッド推奨寸法 (SON1408-3)

